

证券代码：002913

证券简称：奥士康

**奥士康科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告**

ASKPCB 奥士康

二〇二五年七月

为推动奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公司”）业务发展，进一步增强公司综合实力和核心竞争力，优化公司财务结构，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金。公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高端印制电路板项目	182,004.46	100,000.00
合计		182,004.46	100,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况和公司经营状况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金总额，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际需求，在上述募集资金投资项目的范围内，对募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）项目基本情况

高端印制电路板项目的实施主体为公司全资子公司广东喜珍电路科技有限公司，项目实施地为广东省肇庆市鼎湖区永安镇，本项目投资总额为 182,004.46 万元，其中拟使用募集资金 100,000.00 万元，计划建设期为 24 个月。本项目通过新建生产厂房、引进国内外先进的印制电路板生产设备及配套设施，并招聘高素质的技术、管理和生产人员，旨在扩大公司高多层板及 HDI 板的生产规模，以满足下游客户日益增长的订单需求。本项目建成并达产后扩充公司高多层板及 HDI 板产能，能进一步优化公司产品结构，提升产品竞争力，提高公司收入水平、增强盈利能力。

（二）项目投资概算

本项目总投资金额为 182,004.46 万元，本次拟使用募集资金 100,000.00 万元。

（三）项目实施主体

本项目的实施主体为公司的全资子公司广东喜珍电路科技有限公司。

（四）项目建设期

本项目计划建设期为 24 个月。

（五）项目经济效益分析

本项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。

（六）项目用地情况

本项目实施地点为广东省肇庆市鼎湖区永安镇，本项目在公司现有工业用地上实施建设，广东喜珍电路科技有限公司已取得相关不动产权证书。

（七）项目备案及环评情况

截至本报告公告日，本项目的备案及环评等手续尚在办理过程中。公司将按照相关法律法规要求及时、合规办理。

三、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性

（一）项目实施的必要性

1、响应国家战略布局，推动 PCB 产品高端化发展

深入实施智能制造、推动制造业向高端化智能化发展是我国加快推进制造强国建设的关键措施，对加快发展现代产业体系、巩固壮大实体经济根基、推动实现新型工业化具有重要作用。电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，是制造强国建设的重点领域，而印制电路板作为电子信息产业的基础性核心部件，其高端化发展对电子信息产业的转型升级有着重要作用。近年来，我国政府及相关部门出台的《制造业可靠性提升实施意见》《中国电子元

器件行业“十四五”发展规划（2021-2025）》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》等一系列政策文件指出，积极提升印制电路板产品可靠性，突破核心技术壁垒，鼓励推动产品往高端化发展，提升高端市场占有率。

公司作为国内 PCB 行业的领军企业之一，始终坚持突破行业关键核心技术及研发生产高端产品，通过引进先进技术与设备，不断提升产品的技术含量与品质水平，已具备高频高速、高密度互连等高端 PCB 产品的生产能力。但目前国内高端 PCB 产品仍存在产能布局不充分、规模化供应能力有待提升等问题，特别是在 AI 服务器、AIPC、汽车电子等关键应用领域，下游客户对国产 PCB 厂商在稳定供应、快速响应、高一致性等方面提出了更高的要求。

通过本项目的实施，可以显著扩大高端 PCB 产品产能、引入先进生产设备、精进工艺技术，全面提升公司在高精密多层板及 HDI 板等高端产品的综合制造能力、配套供应能力及质量可靠性，更好地满足下游客户对国产高端 PCB 产品的供应稳定性、产品一致性、高效交付能力的需求。

2、积极建设高端 PCB 产能，满足下游行业及市场需求

当前，全球科技产业正经历以人工智能技术为代表的新一轮技术变革，算力基础设施、人工智能终端、智能电动汽车等高成长赛道快速发展，电子信息产业整体结构迎来关键重塑，催生出对 PCB 产品更高性能、更高散热性、更高信号传输速率以及更高可靠性和集成度的进一步需求。作为集成电路及各类电子元器件的关键基础性载体，PCB 行业正面临需求规模和技术复杂度同步提升的关键阶段。

在 AI 算力领域，AI 服务器、边缘计算设备逐渐取代传统通用服务器，逐渐成为新一代算力基础设施的主力，进而推动高多层板及 HDI 板需求的快速放量；在 AIPC 与智能终端领域，终端设备正加速朝着小型化、集成化、轻量化、低功耗及多功能化方向演进，对 PCB 的空间利用度、制造工艺、材料性能均提出了全新要求，进而提升高端 PCB 产品的需求；在汽车智能化方面，随着智能座舱、自动驾驶、电控系统渗透率持续提高，单车 PCB 使用量显著增长，产品性能要求也持续跃升。多个细分应用场景对高端 PCB 需求形成强拉动效应，推动行业进入以技术价值驱动的全新增长周期。根据 Prismark 预测，2029 年全球 PCB 产

值将达到 946.61 亿美元，2024 至 2029 年复合增长率为 5.2%。其中，18 层以上的多层板产值增速最快，年复合增长率有望达到 15.7%，HDI 年复合增长率将达到 6.4%。

面对技术变革带来的产业结构调整 and 下游订单结构重构，PCB 企业的产能承接能力与交付保障能力已成为客户遴选供应商的重要考量标准。近年来公司在数据中心及服务器、AIPC、汽车电子等领域积极拓展优质客户资源，产品需求质量与技术要求不断提升，高端 PCB 产品市场需求持续旺盛，公司目前在高端 PCB 产品方面已面临一定产能瓶颈，难以满足下游市场快速增长的需求。为把握产业升级带来的行业机遇，公司亟需进一步扩大高多层板及 HDI 板等高端产品的生产产能，增强高端产品交付能力。

本项目的实施能显著提升公司在高端 PCB 产品的生产制造能力，强化对“复杂、高端、高一致性”的 PCB 产品订单的承接与交付能力，有利于在 AI 服务器、AIPC、汽车电子等多个新兴应用领域形成更强的产能匹配力和供应稳定性，进而提升客户粘性、提升产品市场份额，为公司进一步发展打下坚实基础。

3、完善产品结构布局，契合技术变革趋势，助力可持续发展

近年来，受益于技术变革和制造工艺的持续迭代，PCB 产业正朝着满足下游更复杂化电路布局及更高性能计算需求的方向发展，如何实现在信号传输速度、芯片集成度、复杂互连结构以及高效散热等方面的性能提升已成为行业技术变革主流趋势，对 PCB 生产企业的技术实力和供应能力均提出了更高要求。

公司始终坚持创新驱动发展，深耕 PCB 领域的技术突破与产品升级，持续加大在高端 PCB 产品领域的研发投入与平台构建。凭借前瞻性的战略眼光，公司近年来积极优化产品结构，伴随公司在高多层板及 HDI 板等方向的技术积累不断深化，高端产品出货占比持续提升，产品制造能力逐步向高频高速、高精密度、高集成及高可靠性方向转型升级，呈现出良好的“产品价值上移”态势。目前，部分面向 AI 服务器、AIPC、数据中心等高端应用场景的定制化产品对公司整体产能结构提出了更高的要求。

本次募投项目将聚焦高多层板及 HDI 板等高端产品产能建设，配备高精度

的专用设备与先进制造工艺，引进优秀人才，形成面向高端 PCB 产品的专用生产平台。项目实施后，公司将进一步构建高端 PCB 从产品定义、工程验证、批量制造到持续优化的闭环生态，全面提升高端 PCB 产品的规模化交付能力，推动整体产品结构优化，增强公司核心竞争力，巩固市场竞争地位，为公司构筑抗风险能力、实现长期可持续发展提供核心支撑。

（二）项目实施的可行性

1、国家产业政策积极支持，推动 PCB 行业快速发展

作为电子信息产业的重要基础环节，PCB 行业在电子信息产业链发挥着支撑性关键作用。近年来，我国政府及有关部门积极推出多项产业政策和相关法律法规大力支持 PCB 行业发展，推动 PCB 行业朝着高端化方向进行产业升级。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”数字经济发展规划》《中国电子元器件行业“十四五”发展规划（2021-2025）》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》《制造业可靠性提升实施意见》《广东省建设现代化产业体系 2025 年行动计划》等一系列产业政策对 PCB 等核心电子元器件提出了明确支持，为 PCB 行业未来快速发展提供了政策保障。在多项产业政策积极支持下，我国 PCB 行业保持快速发展，根据 Prismark 数据，2024 年中国 PCB 行业规模达到 412.13 亿美元，位居全球第一，相比 2023 年同比增长 9.0%，预计 2024 年至 2029 年复合增长率为 4.3%。

因此，本项目契合当前国家政策导向和产业发展重点，具备坚实的政策支持基础，行业发展趋势向好，有利于本项目的顺利实施。

2、强大的技术研发实力为项目实施提供保障

公司多年来持续专注于 PCB 领域的技术研发与创新，在汽车电子、AIPC、服务器、新能源等领域建立起深厚的技术储备。公司设立了研究中心和技术研发中心，组建了一支由多名综合实力突出、产业经验丰富的技术人才组成的国际化专业团队，具备国际先进工艺制程、高端设备选型及生产研发的精准把控能力，能够敏锐洞察行业趋势并快速响应客户需求。

公司的技术研发团队持续开展以市场演进趋势与客户需求为导向的技术创

新工作，重点围绕高端服务器、AIPC、汽车电子等高附加值领域进行产品创新，以实现高密度集成、高速信号传输及高可靠性为关键目标，不断提升产品竞争力。在高端服务器领域，公司持续深化线路高密度连接、信号传输优化、多余线路处理及精度控制等关键技术升级，并同步开展适配下一代高速传输标准的材料组合性能与加工研究。在 AIPC 领域，公司已具备高集成度 HDI 产品开发能力，深入研究多项精密封装与微孔技术，实现精准阻抗控制，具备 AIPC 用 HDI 技术和通孔批量生产能力，并同时推进向更高阶技术和精密设备的部署，进一步提升高精度产品的制作能力。在汽车电子领域，公司聚焦汽车电动化和智能化过程中的三电系统及驾驶自动化系统所带来的大规模 PCB 需求，持续投入下一代技术研发，进一步强化在智能汽车领域的优势。

综上，公司在高端 PCB 领域形成了强大的技术研发实力，拥有深厚的先进技术及研发团队储备，具备持续创新的技术优势，为本项目的实施奠定了稳固技术基础。

3、丰富行业头部客户资源为项目实施奠定了客户基础

优质的客户资源是公司持续快速发展的重要保障，经过多年的客户开拓和品牌打造，公司凭借先进的研发技术实力、优异的产品性能、稳定的产品交付质量和专业的客户服务，已积累了丰富的行业头部客户资源并获得客户的认可，与国内外众多知名厂商建立了长期稳定的合作关系。目前，公司已积累了包括华为、中兴、Hitachi、索尼、三星、小米、矢崎、博格华纳、蔚来、联想、华勤、富士通、华硕等在内的一系列全球行业头部优质客户资源。此外，公司持续加大力度开拓新型应用领域客户及海外市场客户，深度挖掘 AI 服务器、AIPC、汽车电子等高端赛道应用场景，不断优化客户结构。

通过与行业头部客户紧密合作，公司能持续紧贴行业前沿技术趋势及市场最新动态，持续推动产品和技术的迭代创新，塑造了强大的品牌影响力，进一步巩固公司的市场地位。

未来，公司将通过持续优化产品结构、提升服务质量，积极开拓新客户，不断壮大客户群体。综上，凭借多年行业深耕，公司拥有优质的头部客户资源和强大的品牌影响力，为本项目新增产能的市场消化提供了有力支撑。

4、完善的生产和质量管理体系为项目实施提供了良好条件

PCB 产品质量及品质稳定性将直接影响下游产品的关键性能，因此产品质量是下游客户筛选合格 PCB 供应商的决定性指标之一。自成立以来，公司一直高度重视产品质量，始终致力于为客户提供质量稳定、性能优异的产品。通过多年的技术和生产经验积累，公司建立了完善、健全、高效的质量管理体系，从产品全生命周期对产品质量进行管控。公司把“一流品质、准确交期、持续改善、满足客户”的品质方针融入生产、管理、服务的各个环节。为切实提高产品质量，公司推行“质量前移”的先进管理理念，将质量控制的关口向前延伸，从源头消除产品质量隐患，并对产品进行研发设计、工艺制定、生产监控、质检验收、质量追溯的全生命周期管理。

综上，公司建立了完善的生产和质量管理体系，在 PCB 制造领域具备丰富生产管理经验，为本次项目顺利实施提供了良好条件和重要保障。

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，是公司现有业务的拓展，面向人工智能及算力等国家战略需求，符合国家产业政策和公司未来整体发展战略方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于促进公司主营业务的持续健康发展。

本次募集资金投资项目的顺利实施，可以进一步扩大公司高多层板和 HDI 板的生产能力，提升产品竞争力，有助于公司更好地满足下游客户的需求，扩大市场份额并巩固行业地位，提升公司盈利能力和可持续发展能力，进而提高公司的整体竞争力和抗风险能力，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，从而增强公司的资金实力，保障公司持续稳健发展。在可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，同时能够维持较为合理的资产负债率，有利于提高经营效率；随着可转换公司债券陆续转股，公司的

资本实力将得以加强，资产负债率将逐步降低，偿债风险也随之降低，资本结构得以优化，抗风险能力将得以提升，为未来可持续发展提供良好保障。但是公司总股本也有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例和每股收益产生一定的摊薄作用。

本次募集资金投资项目预计具有良好的经济效益，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步提升，进一步增强公司综合实力，促进公司持续健康发展，为公司股东贡献回报。

五、可行性分析结论

综上所述，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向符合国家产业政策和公司战略发展的需要，募投项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，募集资金的使用将会为公司带来良好的经济效益，有利于优化公司财务结构，满足公司业务扩张的需求，并将进一步壮大公司的经营规模和综合实力，提高公司经营效益和核心竞争力，有利于公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

奥士康科技股份有限公司

2025 年 7 月 31 日